
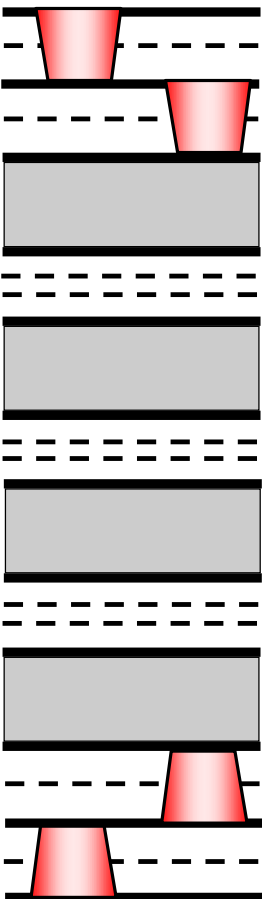


STANDARDLAGENAUFBAU HDI											
HDI12_2+8+2_1,45_17,5		12 - Lagen									
		Kerne: 0,15 mm Cu 17,5/17,5 µm									
WE-Artikel Nr.:		2 + 8 + 2									
KUNDE:											
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG		
KUNDE	WE							[µm]	[µm]		
1	TOP/VS						Folie	12 µm	1)	12	
									1 x 1080	60	
2	VSK1						Folie	12 µm		30	
									1 x 1080	66	
3	2							17,5 µm		16	
							0,150 mm			150	
4	3							17,5 µm		16	
									2 x 1080	134	
5	4							17,5 µm		16	
							0,150 mm			150	
6	5							17,5 µm		16	
						2 x 1080	134				
7	6				17,5 µm		16				
				0,150 mm			150				
8	7				17,5 µm		16				
						2 x 1080	134				
9	8				17,5 µm		16				
				0,150 mm			150				
10	9				17,5 µm		16				
						1 x 1080	66				
11	RSK1			Folie	12 µm		30				
						1 x 1080	60				
12	BOT/RS			Folie	12 µm	1)	12				
				1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm							
				Gesamtdicke Material:			1466				
				Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)							
MATERIALDICKE:		1,45	+/-	0,11	mm	Datum:		Bearbeiter:			
DICKE über galv. Endoberfläche		1,54	+/-	0,14	mm						
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,60	+/-	0,16	mm						
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:					
Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision					
28.03.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00		Seite: 7+			